**焦化厂零膨胀硅砖**技术要求

1. 明细要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 砖号 | 数量（块） |
| 1 | S6617 | 100 |
| 2 | S6618 | 200 |
| 3 | S6620 | 200 |
| 4 | S6623 | 100 |
| 5 | S6624 | 100 |
| 6 | S6632 | 100 |
| 7 | S6661 | 100 |
| 8 | S6664 | 100 |
| 9 | S01 | 1000 |

1. 指标要求

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 指标 |
| 体积密度 | ≥1.85g/cm3 |
| 气孔率 | ≤20% |
| 常温耐压强度 | ≥30.0MPa |
| 热膨胀率（1000℃） | ≤0.2% |
| 荷重软化温度 | ≥1650℃ |
| SiO2 | ≥99% |
| AL2O3 | ≤0.3% |
| Fe2O3 | ≤0.1% |
| CaO | ≤0.1% |
| 水冷次数 | 1100℃ 不小于30次 |

1. 其他指标参照技术协议要求执行。
2. 祥见图纸。